芯联集成电路制造股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 1 月 10 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕1 号），并于 2025 年 3 月 15 日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2024 年 4 月 30 日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，金证（上海）资产评估有限公司以 2024 年 10 月 31 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。鉴于评估数据更新，公司对草案（修订稿）再次进行修订、补充及完善，主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	补充加期评估基准日、加期评估报告的释义
重大事项提示	1、补充披露加期评估相关内容； 2、更新本次重组对上市公司股权结构的影响
重大风险提示	1、更新本次交易的董事会审议情况； 2、补充披露贸易摩擦和关税壁垒带来的市场风险； 3、补充披露贸易摩擦及供应链风险

章节	修订情况
第一章 本次交易概况	1、补充披露加期评估相关内容； 2、更新本次重组对上市公司股权结构的影响； 3、更新本次交易的董事会审议情况
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司注册资本、历史沿革情况
第六章 标的资产评估作价情况	补充披露加期评估相关内容
第十二章 风险因素分析	1、更新本次交易的董事会审议情况； 2、补充披露贸易摩擦和关税壁垒带来的市场风险

除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年4月23日